

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMA ST.91 DE LA OMPI

*Resultados de la encuesta presentados al Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)
en su duodécima sesión, el 19 de septiembre de 2024*

INTRODUCCIÓN

1. En su undécima sesión, celebrada en diciembre de 2023, el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) aprobó el cuestionario sobre la aplicación de la Norma ST.91 por parte de las Oficinas de Propiedad Intelectual (PI). El CWS pidió a la Secretaría que emitiera una circular en la que invitara a las Oficinas de PI a responder a esta encuesta (párrafo 87 del documento CWS/11/27).

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

2. En marzo de 2024, la Secretaría emitió la circular C.CWS.179 en la que invitaba a las Oficinas de PI a participar en la encuesta sobre la aplicación de la Norma ST.91 de la OMPI. La encuesta se realizó entre marzo y abril de 2024.

3. Los 22 miembros del CWS participaron en la encuesta: Oficinas de los siguientes Estados miembros: Alemania (DE), Australia (AU), Bhután (BT), Bulgaria (BG), Canadá (CA), Croacia (HR), Eslovaquia (SK), Estonia (EE), Gambia (GM), Federación de Rusia (RU), Hungría (HU), Italia (IT), Japón (JP), Lituania (LT), Namibia (NA), Reino Unido (GB), República Árabe Siria (SY), República Checa (CZ) y República de Corea (KR); y las siguientes Oficinas regionales: Oficina Eurasiática de Patentes (EA), Oficina Europea de Patentes (EP) y Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EM). Las respuestas individuales de las Oficinas y las respuestas cotejadas están disponibles en la [Parte 7 del Manual de la OMPI](#).

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

4. Entre las respuestas, 12 participantes (55 %) indicaron que aún no utilizan modelos, imágenes o estructuras químicas tridimensionales; nueve (41 %) indicaron que sí los utilizan; y uno (5 %) indicó un uso especial en su respuesta.

5. Entre quienes respondieron que utilizan modelos, imágenes o estructuras químicas en 3D: el 67 % utiliza el 3D para diseños industriales, el 56 % para marcas, el 44 % para patentes, el 22 % para modelos de utilidad y el 22 % para otros derechos de PI.

6. Cabe señalar también que, entre las Oficinas que respondieron, la mayoría (64 %) no aplica la Norma ST.91 de la OMPI, mientras que el 27 % la aplica parcialmente y el 9 % la aplica en su totalidad.

7. En cuanto al uso de los formatos de archivo recomendados por la Norma ST.91 que reciben actualmente las Oficinas de PI:

| Derecho de PI | Formato de archivo más utilizado (por orden) |
|---|--|
| Marcas | OBJ, STL, 3D PDF |
| Diseños industriales | 3D PDF, OBJ, STL, STEP |
| Patentes (incluidas las estructuras químicas) | 3D PDF, STEP |
| Modelos de utilidad | 3D PDF |

8. En cuanto a la publicación de modelos, imágenes o estructuras químicas 3D, recomendada por la Norma ST.91, las Oficinas indicaron que la mayoría no publican la información en 3D recibida aunque haya sido aceptada. Los formatos más utilizados para las marcas son OBJ y STL, mientras que los formatos más utilizados para la publicación de diseños industriales, patentes y modelos de utilidad es 3D PDF. Del mismo modo, en la pregunta relativa a la publicación en papel de objetos 3D, la mayoría de las Oficinas que respondieron no publican información de modelos, imágenes o estructuras químicas 3D en papel aunque hayan sido aceptados por la Oficina. Las Oficinas que sí publican

objetos 3D en papel publican los objetos 3D utilizando representaciones 2D generadas a partir de los modelos o imágenes 3D de origen para todos los derechos de PI indicados en la encuesta.

9. Cabe señalar que ninguna Oficina de PI utiliza los formatos 3D recomendados para la topología de circuitos integrados, sea para su presentación o su publicación.

10. Durante el examen, la mayoría de las Oficinas utiliza representaciones en 2D para la comparación de los modelos y las imágenes en 3D en lugar de los propios modelos o imágenes en 3D.

[Fin del documento]